



2025年2月12日

各 位

会社名 株式会社ジェイテックコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 津村 尚史  
(コード番号：3446 東証プライム)  
問合せ先 取締役 管理部長 日谷 哲也  
(TEL. 072-655-2785)

### 長期成長戦略「Innovation2030」の追加資料について

当社は、これまでのニッチトップ戦略で培った独自技術を、半導体のように大きな市場を対象に、またこれから成長が見込まれる再生医療分野に適用・展開するために2022年5月に長期成長戦略「Innovation2030」を発表しました。

この度、長期成長戦略「Innovation2030」について、新たな資料を取りまとめましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 「Innovation2030」の追加資料について

「Innovation2030」の目標達成に向けた今後の取り組みについて、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様へ、より一層ご理解を深めていただくことを目的として、各セグメントの方針をより具体的にお示しする資料を取りまとめました。

「Innovation2030」の策定より間もなく3年が経過し、2025年7月にフェーズ1（成長のための土台作り）からフェーズ2（成長の推進）への移行に伴い、ステークホルダーの皆様にご理解をいただけるよう、当社の成長目標を改めて明確にし、企業価値の更なる向上を目指します。

当社は、「Innovation2030」に基づき、以下の施策強化を改めて明確にいたします。

- ①半導体関連市場向け製品の事業化を加速し、業界でのプレゼンスを確立
- ②再生医療市場の成長を取り込み、医療機関との連携を強化
- ③積極的なM&A戦略を通じて、技術力・市場シェアを拡大
- ④企業価値向上を重視し、持続可能な企業経営を実現

当社は、技術革新と市場拡大を通じて、「Innovation2030」をさらに推進し、より多くのステークホルダーの皆様へ価値を提供してまいります。

今後とも、当社へのご支援・ご期待を賜りますようお願い申し上げます。

## 2. Innovation2030追加資料の詳細

別紙をご参照ください。

### (注)

本長期成長戦略「Innovation2030」につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上

# Innovation2030

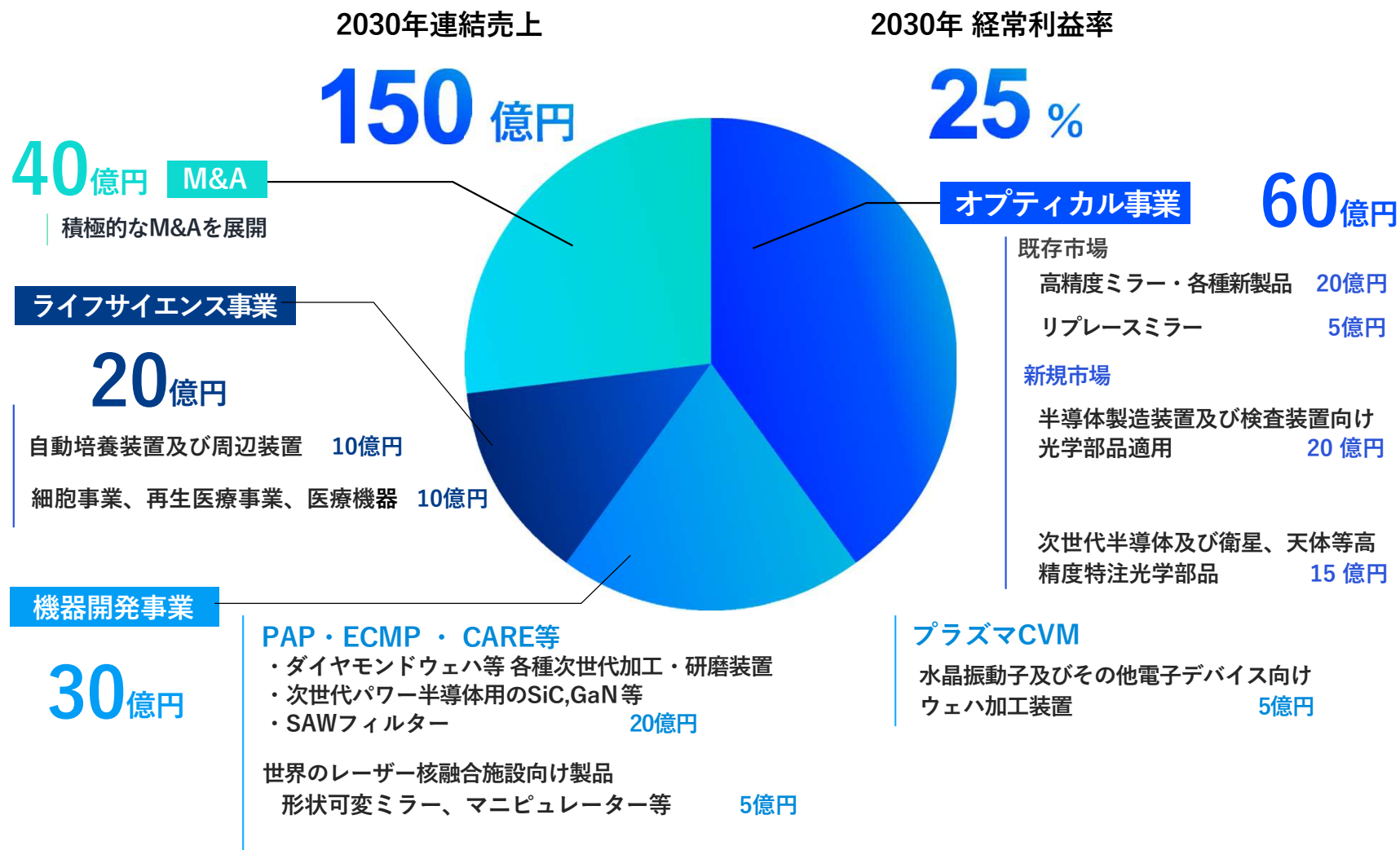
## の実現に向けて

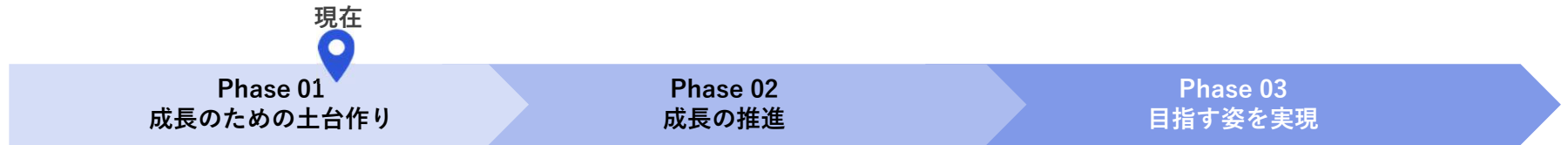
---

長期成長戦略「Innovation2030」は、これまでのニッチトップ戦略で培った独自技術を、半導体分野のような大きな市場や、これから成長が見込まれる再生医療分野に適用・展開するための施策

---

# Innovation2030の売上目標





**土台** 放射光用ミラーの新製品展開

市場規模 240億円

現状の進捗

放射光用ミラー新製品の販売に注力

- ・回転体ミラー
- ・形状可変ミラー
- ・X線用結晶部品 など

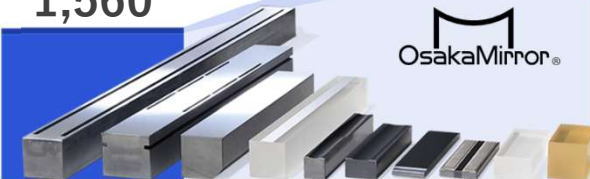
産学連携による半導体関連光学部品の研究開発に注力

【独自技術】ミラー加工計測装置



売上 (百万円)

1,560

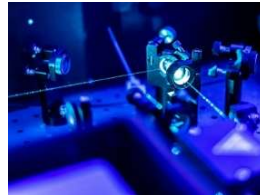


2025/6

**成長** 半導体関連光学部品の開発・展開

市場規模 1,900億円

急成長



高精度レンズ



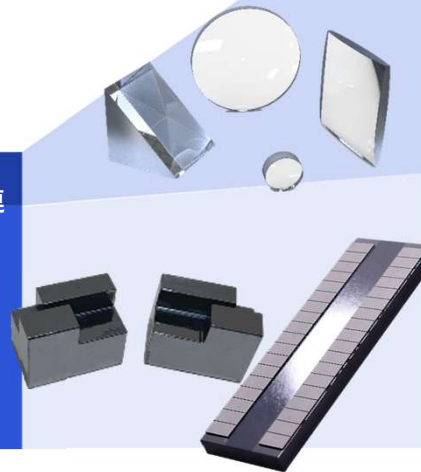
窓材

3,050

B to B 半導体関連

B to G 放射光用ミラー

2028/6



**目指す姿** 半導体関連光学部品の拡販 (高精度ミラー)

市場規模 5,000億円

6,000

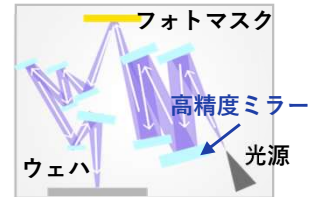
B to B 半導体関連

B to G 放射光用ミラー

2031/6

半導体製造装置・検査装置向け光学部品 2,000 (百万円)  
次世代半導体向け光学部品 衛星天体等高精度光学部品 1,500 (百万円)

高精度ミラー・各種新製品 2,000 (百万円)  
リプレースミラー 500 (百万円)



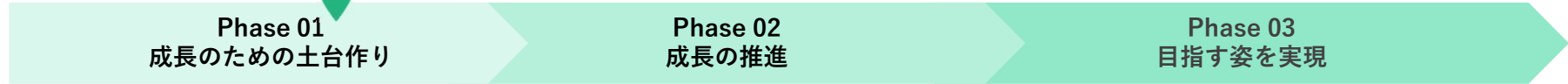
EUV露光装置の概要

Business Expansion

Core Business

# 独自の加工・研磨技術を半導体加工用装置市場へ

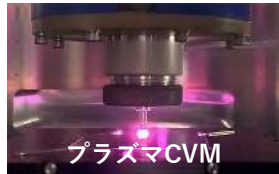
現在



**土台** プラズマCVM装置、PAP装置、ECMP装置の早期売上形成

**成長** 半導体市場へタイムリーに参入  
パワー半導体基板向け各種研磨装置の販売

**目指す姿** 第二の事業の柱に成長  
次世代半導体や化合物半導体ウェハ向けに、加工・研磨装置が本格導入、大きく売上貢献

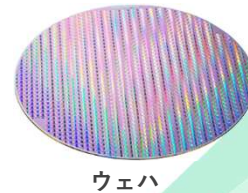
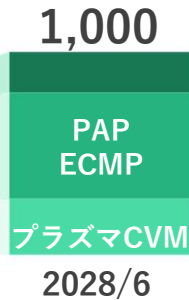


プラズマCVM・PAP・ECMP・CAREは、それぞれ大学発の独自の精密加工・研磨技術であり、実用化を推進し、早期市場導入を目指しています

**現状の進捗**

- プラズマCVM：国内外で水晶振動子ウェハ加工装置として注力
- PAP：ダイヤモンドウェハ等の研磨試作向けの装置として複数納入
- ECMP/CARE：半導体メーカー等からの試作評価が順調に進展

売上 (百万円)



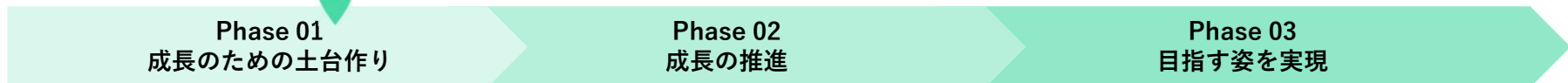
半導体研磨装置市場  
2024年 0.5兆円  
EV, AI  
5G・6Gの普及  
年々拡大  
2031年 2.3兆円

- 形状可変ミラー・マニピュレーター等 500 (百万円)
- ・ダイヤモンドウェハ等 各種次世代加工・研磨装置
- ・次世代パワー半導体用の SiC, GaN 等
- ・SAWフィルター 2,000 (百万円)

水晶振動子及びその他電子デバイス向けウェハ加工装置 500 (百万円)

独自の細胞培養及び分離技術により高齢化社会・人口減少積極的に対応

現在



**土台** 労働人口減少で注目を浴びている自動細胞培養装置の販売拡大



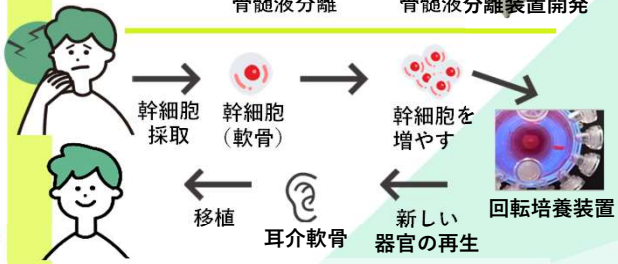
**現状の進捗**  
 大手製薬会社を中心に引き合いがある自動細胞培養装置の営業活動に注力  
 認知症の自由診療で使用する骨髄液分離装置の導入に向け、病院とアライアンスを構築中  
 軟骨再生治療に向けた研究開発推進中

**成長** 認知症・脳梗塞等治療に用いる骨髄液分離装置の開発、試験販売を推進



**目指す姿** 医療・高齢問題に対応し、再生医療等製品(軟骨など)製造のための独自の細胞培養装置や、医療機器としての骨髄液分離装置の市場展開が加速

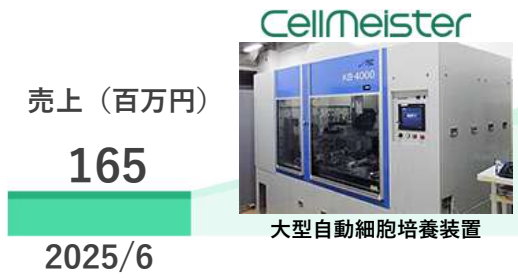
再生医療市場	2025年 3.8兆円	拡大	2030年 7.5兆円	医療現場	美容整形での実用化へ
--------	-------------	----	-------------	------	------------



軟骨再生治療に向けた研究開発推進中

550  
自動培養装置及び周辺装置

軟骨再生用培養装置

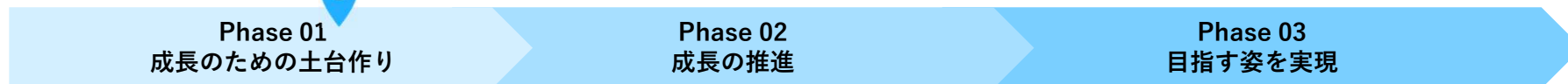


2028/6

2031/6

## シナジー効果のある企業との相乗的な成長を目指す

現在



**土台** 電子科学株の新規開拓市場で主力製品の販売が増える

**成長** 積極的なM&Aを展開  
当社とのシナジーが期待できる複数の会社のM&Aを実施

**目指す姿** 当社と子会社の相補的な関係を構築し、順次の売上拡大を実現する

### 現状の進捗

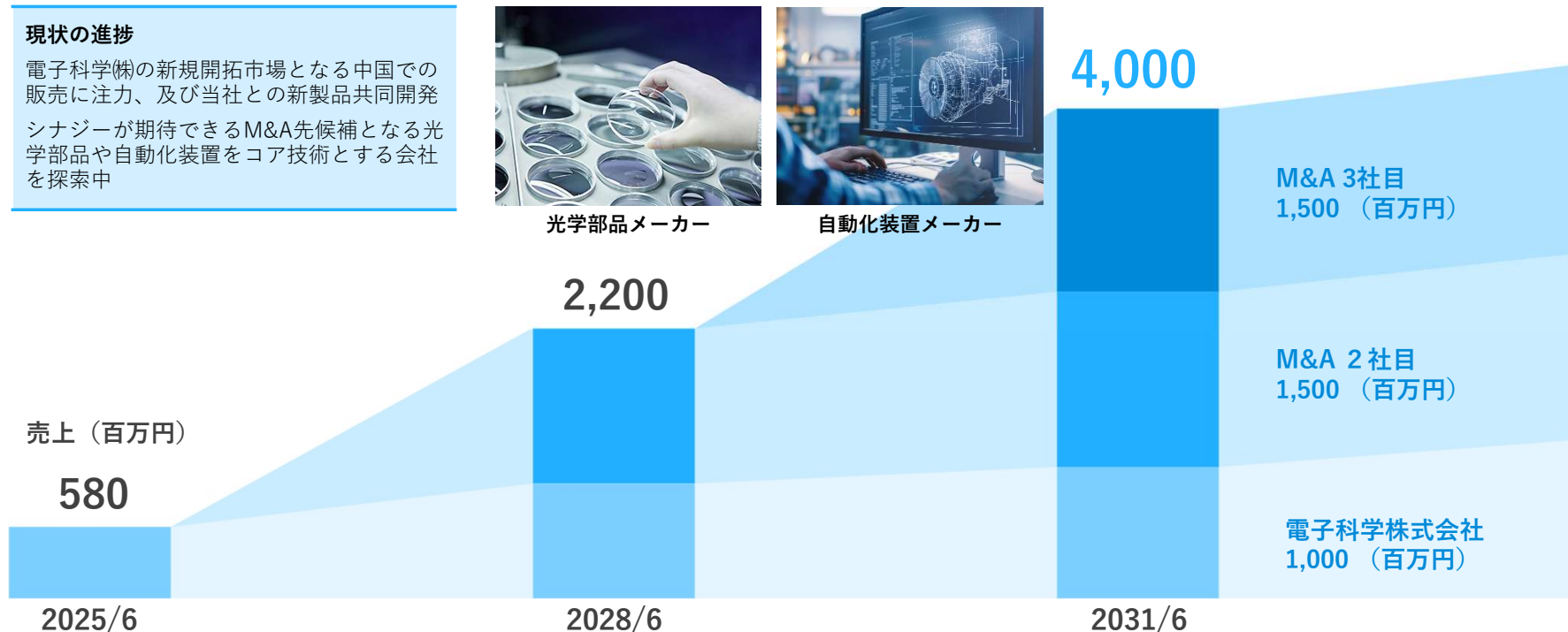
電子科学株の新規開拓市場となる中国での販売に注力、及び当社との新製品共同開発シナジーが期待できるM&A先候補となる光学部品や自動化装置をコア技術とする会社を探索中



光学部品メーカー



自動化装置メーカー

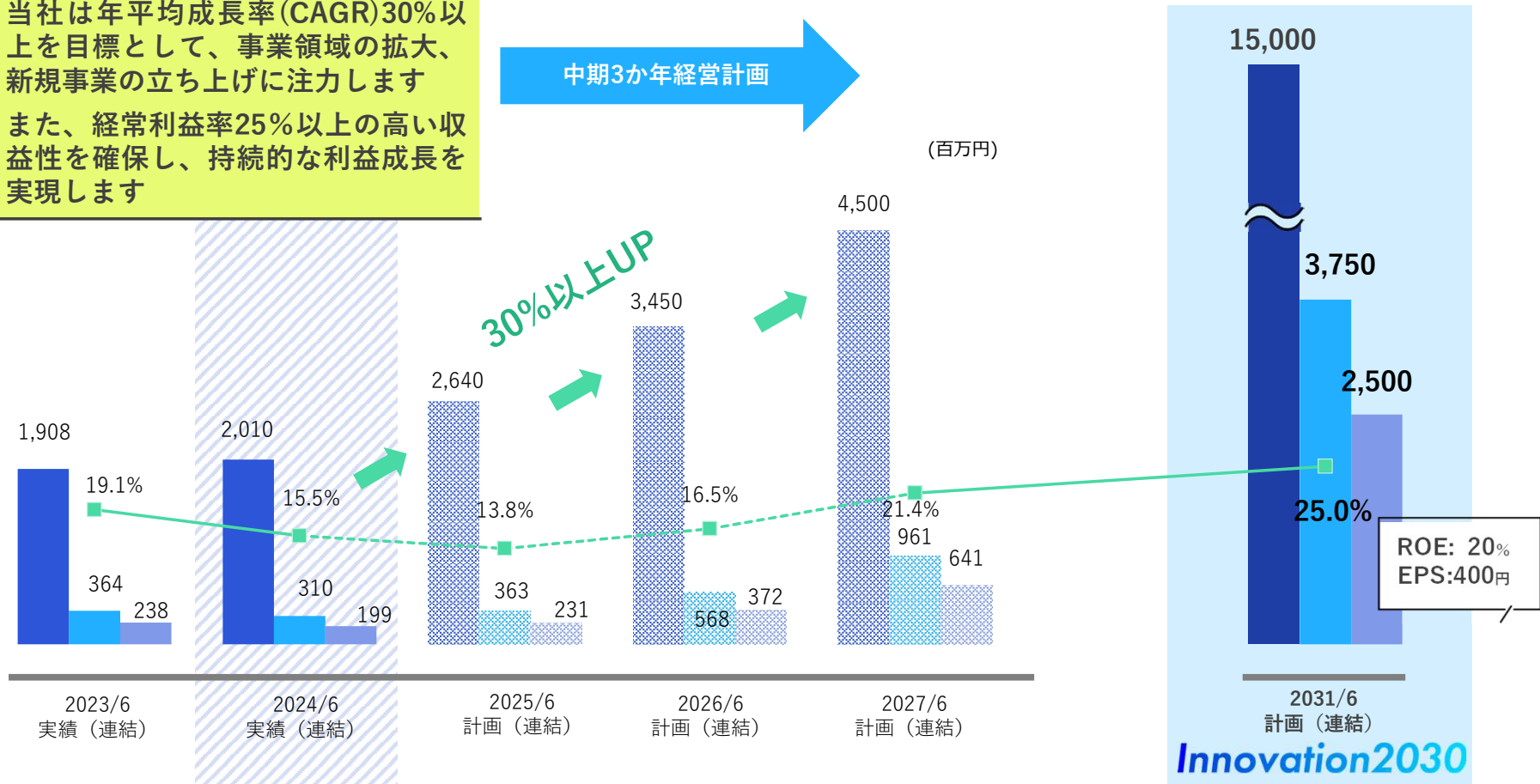
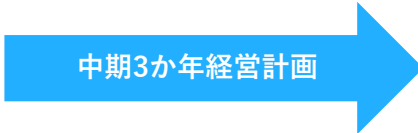




# Innovation2030 までのマイルストーン

■ 売上高    ■ 経常利益    ■ 当期純利益    ■ 売上高経常利益率

当社は年平均成長率(CAGR)30%以上を目標として、事業領域の拡大、新規事業の立ち上げに注力します  
また、経常利益率25%以上の高い収益性を確保し、持続的な利益成長を実現します



技術名	技術内容	事業化状況				
		研究開発	ユーザーサンプル テスト加工	スタンドアロン 装置販売	パイロットライン 装置販売	生産ライン 装置販売
<b>プラズマCVM</b> Plasma Chemical Vaporization Machining ECO	<b>技術の特徴：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>高密度のラジカルを利用した基材表面のエッチング加工</li> <li>高効率で歪を生じない加工</li> <li>厚み測定器と組み合わせたNC加工により、基板平坦性(TTV)向上</li> </ul> <b>被加工物：</b> Si及びSiO <sub>2</sub> (水晶、ガラス)基板	■	■	■	■	■
<b>PAP</b> Plasma Assisted Polishing ECO	<b>技術の特徴：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラズマによる基材表面の活性化現象を利用した硬質材料の高速研磨加工</li> <li>研磨剤、スラリーを用いないドライ&amp;クリーン加工</li> </ul> <b>被加工物：</b> ダイヤモンド(単結晶、多結晶)	■	■	■	■	■
<b>ECMP</b> Electro-Chemical Mechanical Polishing ECO	<b>技術の特徴：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>基板表面の陽極酸化(軟質化)現象を利用した高速研磨加工</li> <li>イオン導電性パッドを用い、薬液(電解液)を使用しないクリーンな加工</li> </ul> <b>被加工物：</b> SiC ウェハ	■	■	■	■	■
<b>CARE</b> CAlyst Referred Etching ECO	<b>技術の特徴：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>触媒機能を持つパッドによる原子スケールでの平坦化加工</li> <li>加工変質層、ダメージ層のない原子レベルで欠陥のない表面を創出</li> <li>媒体は純水のみで、研磨剤等のメディアが不要でクリーンな加工</li> </ul> <b>被加工物：</b> Si、水晶、サファイア、GaN、SiC、LT/LN等種々の半導体基板	■	■	■	■	■